

# 2013年3月期(2012年度) 決算説明会

2013年5月29日(水)

株式会社リョーサン

# 2012年度業績結果と2013年度業績予想

## 経営執行報告(2011～2012年度)

## 2013年度「経営の取り組み」

## 【別添】技術活動の紹介

### 資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

- ・主要市場(日本、アジア等)の経済状況、消費動向及び製品需給の急激な変動
- ・ドル等の対円為替相場の大幅な変動
- ・資本市場における相場の大幅な変動等

# 2012年度業績結果と2013年度業績予想

経営執行報告(2011～2012年度)

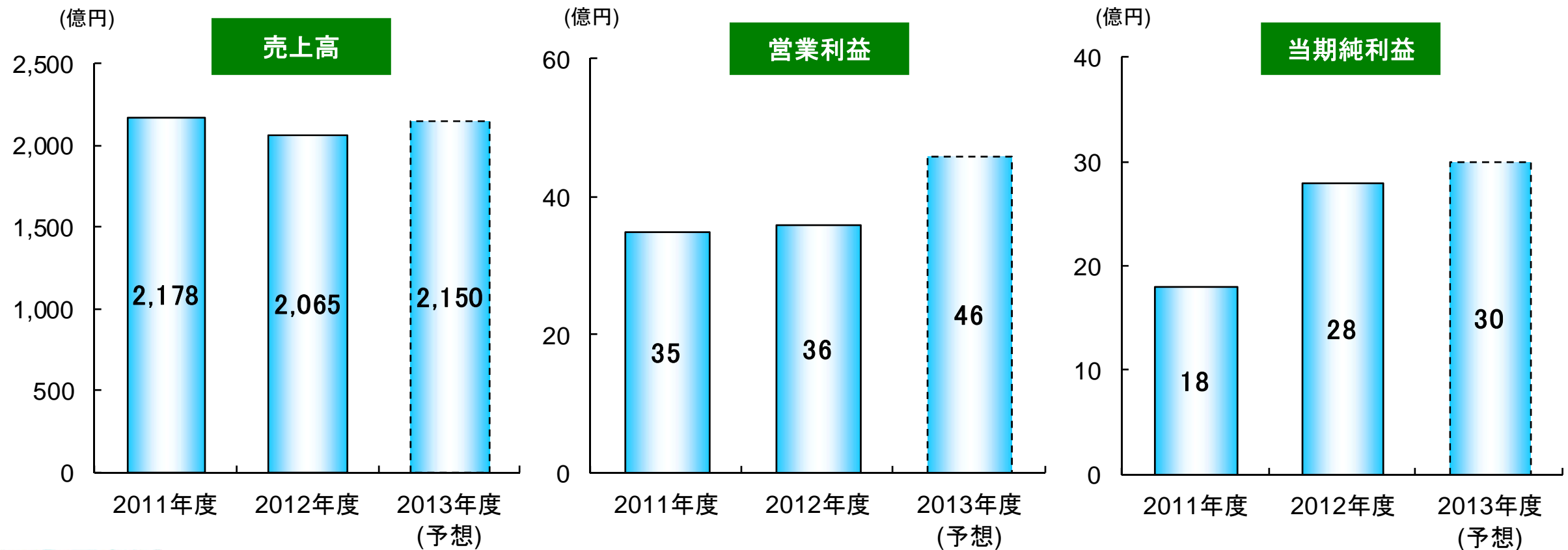
2013年度「経営の取り組み」

【別添】技術活動の紹介

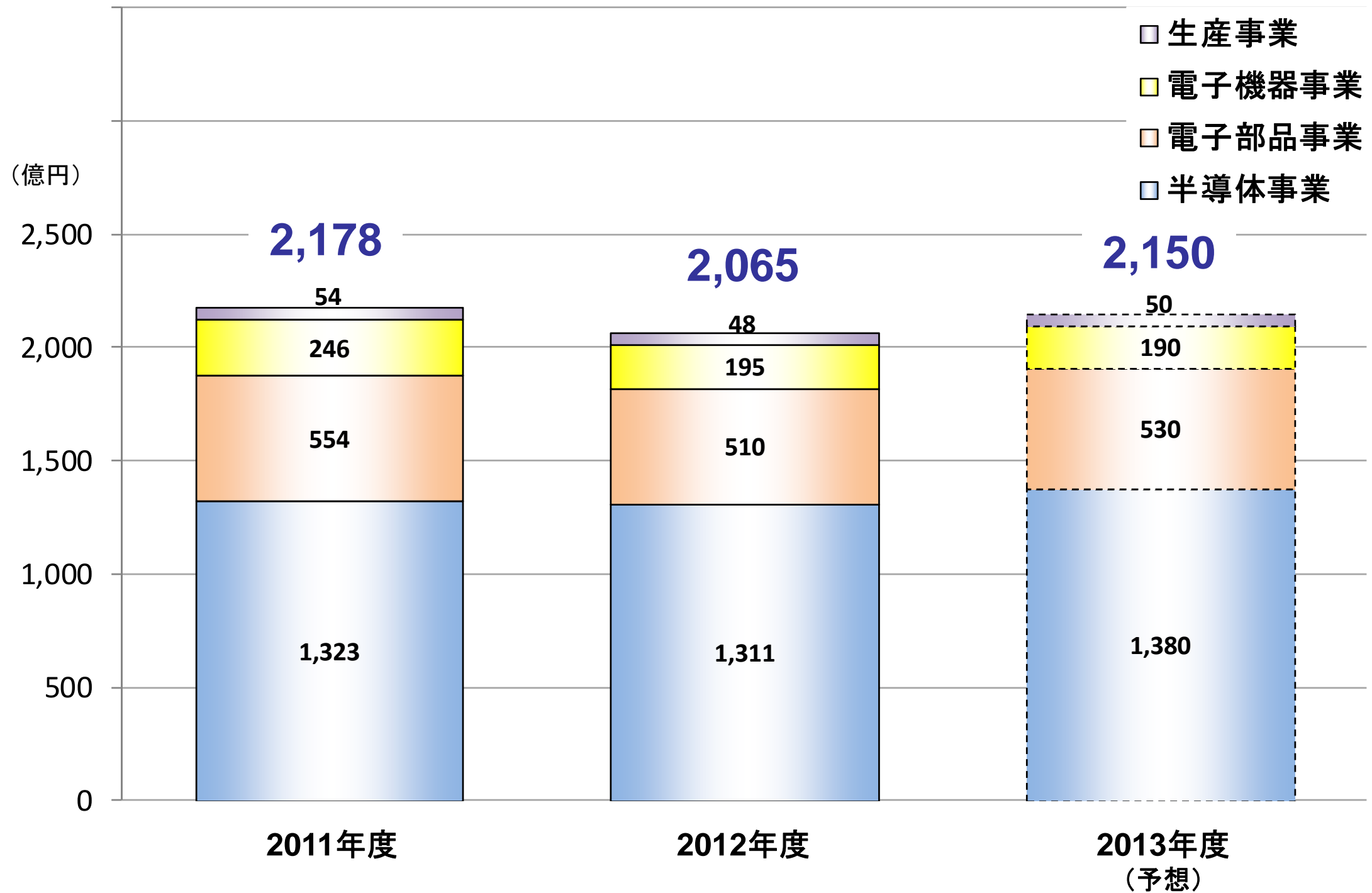
# 連結業績の概要

単位: 億円

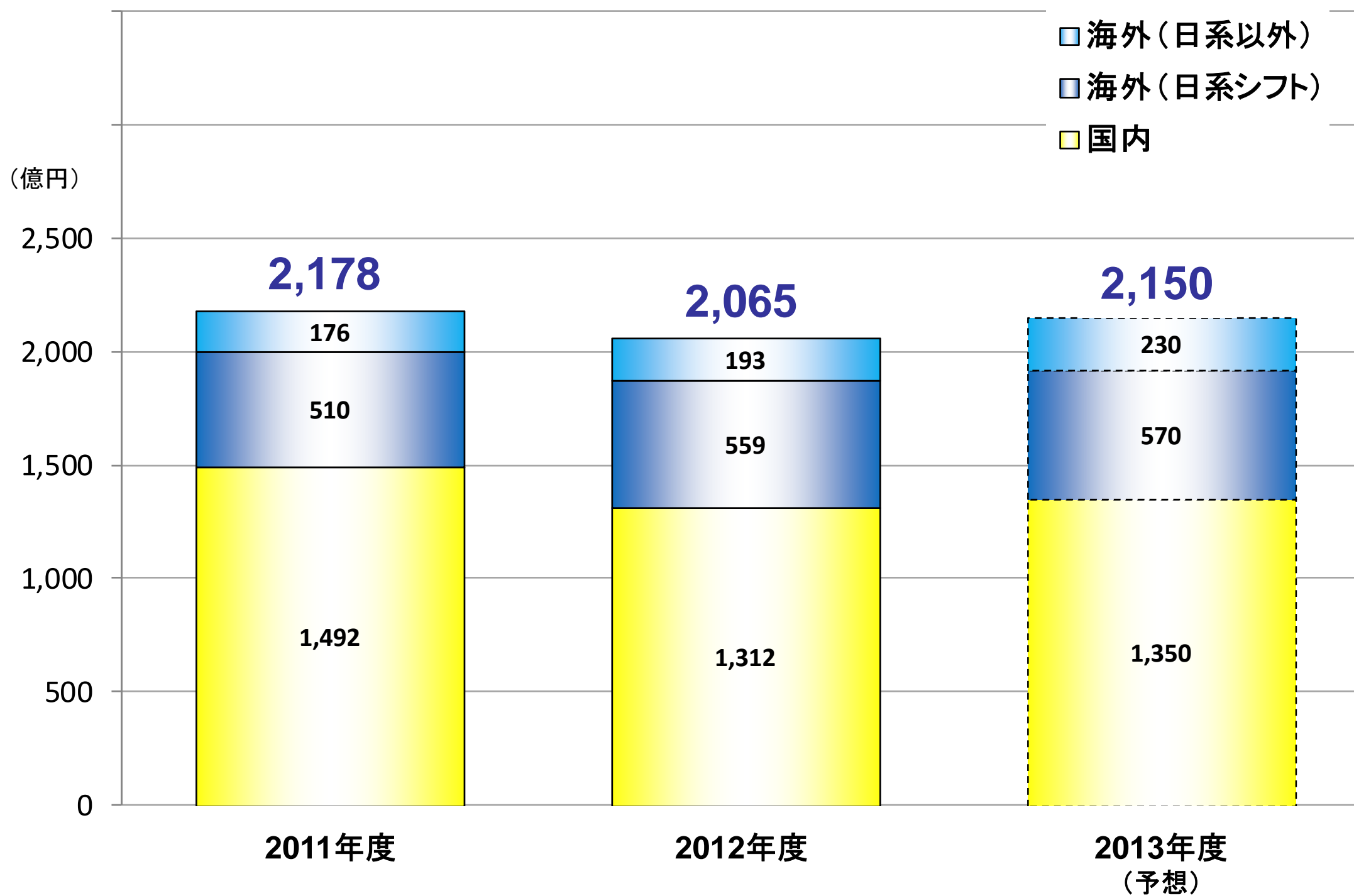
	2011年度		2012年度			2013年度(予想)		
		売上高比		売上高比	前年比		売上高比	前年比
売上高	2,178	%	2,065	%	△5.2%	2,150	%	+4.1%
売上総利益	167	7.7	166	8.1	△0.6%	176	8.2	+5.6%
販管費	132	6.1	129	6.3	△2.0%	130	6.0	+0.1%
営業利益	35	1.6	36	1.8	+4.6%	46	2.1	+25.2%
経常利益	44	2.1	41	2.0	△8.1%	48	2.2	+16.7%
当期純利益	18	0.9	28	1.4	+48.2%	30	1.4	+6.6%
1株当たり当期純利益	55円90銭		84円40銭			92円41銭		



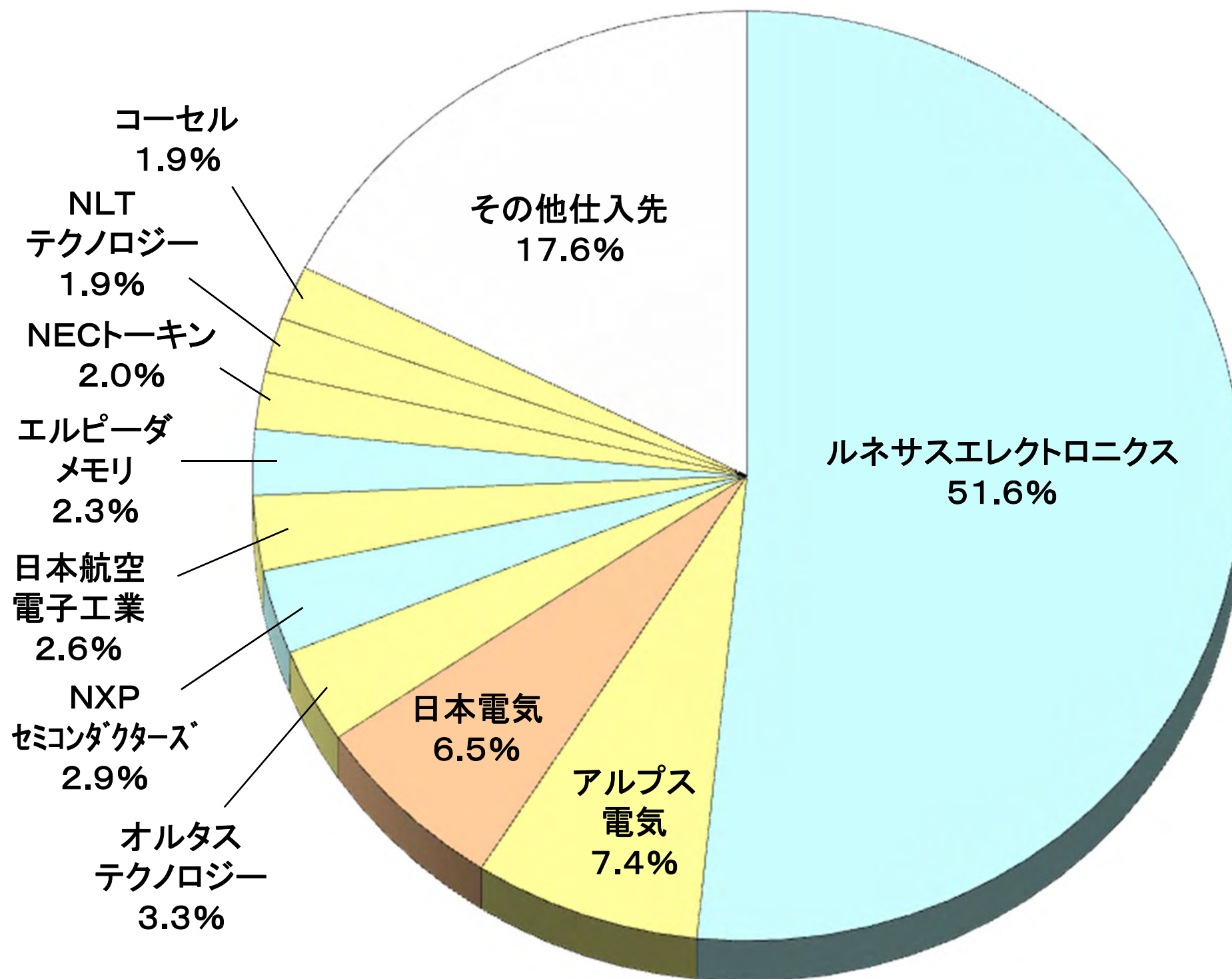
# 事業別の売上高推移



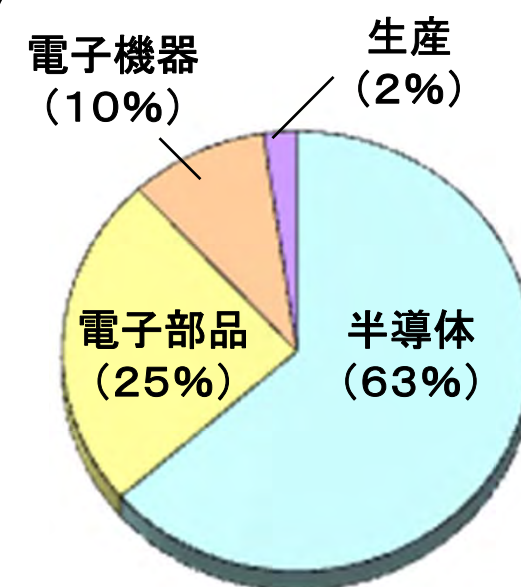
# 国内・海外の売上高推移



# 2012年度 主要仕入先



【事業別売上構成比】



※敬称略

※構成比(%)は各仕入先商品の2012年度売上実績に基づく

# 2012年度 主要得意先

## 《売上高上位40社》

	上位1～10社	上位11～20社	上位21～30社	上位31～40社
顧客名	カシオ計算機 デンソー 日立製作所 三菱電機 日本電気 ニコン オムロン パナソニック パイオニア ワコム	アルパイン アルプス電気 ブラザー工業 カルソニックカンセイ キヤノン 富士フイルム マミヤ・オーピー 任天堂 SAMSUNG(韓) 住友電装	BLUEWAY(中) クラリオン 富士ゼロックス 現代自動車(韓) JABIL(米) JVCケンウッド コニカミノルタ 東芝テック ヤマハ 矢崎総業	アドバンテスト ARIMA(台) 富士通 古野電気 NLTテクノロジー シャープ スタンレー電気 対松堂精工 TOPRO(中) ヨコオ
売上高 構成比	(上位10社) 51%	(上位20社) 68%	(上位30社) 76%	(上位40社) 80%

## 《事業別 売上高上位5社》

半 導 体	電 子 機 器
三菱電機 日本電気 ニコン パイオニア ワコム	デンソー 富士ゼロックス 日本電気 ニコン パナソニック
(上位5社) 49%	(上位5社) 48%
電 子 部 品	生 産
カルソニックカンセイ キヤノン 三菱電機 日本電気 任天堂	デンソー ファナック 日立製作所 三菱電機 パナソニック
(上位5社) 28%	(上位5社) 42%

※敬称略

※順位、構成比(%)は2012年度売上実績に基づく

※(韓)は韓国、(台)は台湾、(中)は中国、(米)は米国の顧客

(アルファベット順)

(アルファベット順)



2012年度業績結果と2013年度業績予想

経営執行報告(2011～2012年度)

2013年度「経営の取り組み」

【別添】技術活動の紹介

## 成長戦略

◇急成長する新興国市場(中国・インド)への取り組み強化

☞インドにおいて、現地STBメーカーとビジネス開始

◇グローバル化する日系顧客への対応強化

☞ヨーロッパ(ドイツ)において、日系メーカー(車載・電装系)とビジネス開始

◇成長分野(カーエレクトロニクス・社会インフラ等)の開拓強化

☞日系顧客を主体に拡販継続中

## セグメント戦略

### <技術戦略>

◇システム技術力と開発力を付加価値とした  
半導体売上と利益極大化への貢献

☞別添参照

### <半導体事業>

☞新規ラインカードとして、海外半導体メーカー4社と取引開始

☞韓国大手自動車メーカーとの取引拡大  
(12年度は10年度比約2倍の実績)

## セグメント戦略

### <電子部品事業>

☞ 新規ラインカードとして、電子部品メーカー2社と取引開始

### <電子機器事業>

☞ HEMS(ホームエネルギー・マネジメントシステム)において  
ソフト・ハードウェア開発の受託商談推進  
一部、受託開発決定

### <生産事業>

☞ 自社製品(ヒートシンク)で、社会インフラ市場向け  
新製品(ファインピッチKBS)を投入

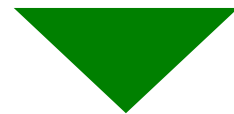
## インフラ戦略

- 👉 インド(バンガロール)に拠点(シンガポールリョーサンの支店)を設立
- 👉 ドイツ(ミュンヘン)に現地法人(Ryosan Europe GmbH)を設立
- 👉 12年6月 社外取締役を1名選任
- 👉 13年度より全部連結を実施(新会計システム導入)

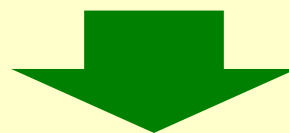
## 足下を固める

### ◇収益体質の改善

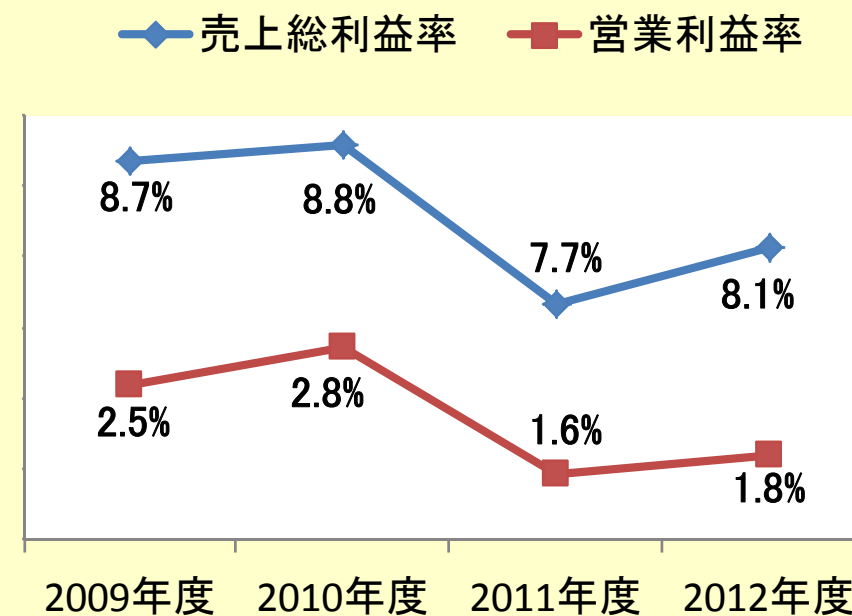
- ・主力サプライヤーの事業構造改革や、日本のエレクトロニクス産業の低迷により、収益体質が悪化



- ・売上総利益率は改善傾向にあるものの、過去の水準からすれば低水準
- ・売上高もこの数年2,000億円程度に低迷、成長性に課題



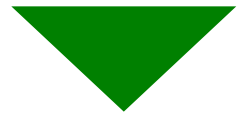
「13年度経営の取り組み」  
で継続



## 足下を固める

### ◇財務体質の改善

- ・棚卸資産の金額は減少したが  
回転月数は目標に届かず

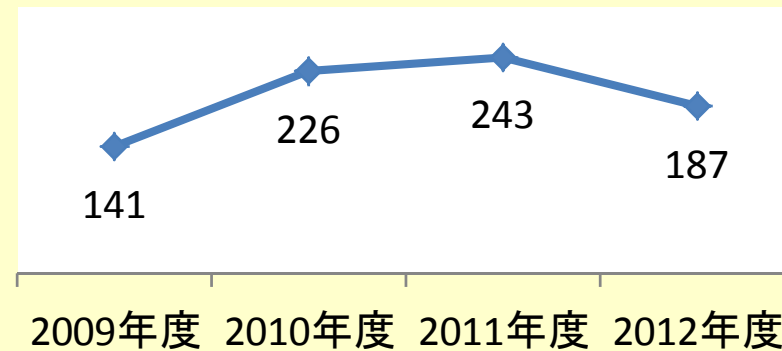


- ・棚卸資産の減少は、売上高の  
低迷が主要因であり、管理の  
徹底は不十分

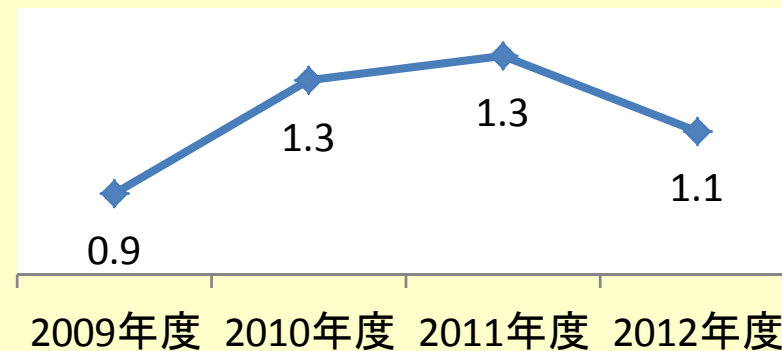


「13年度経営の取り組み」  
で継続

棚卸資産(額) <億円>



棚卸資産(回転月数) <ヶ月>



2012年度業績結果と2013年度業績予想

経営執行報告(2011～2012年度)

2013年度「経営の取り組み」

【別添】技術活動の紹介



## 【現状認識】

### 外部環境の変化

- ◇世界的な経済・産業構造の変化
- ◇半導体業界内での構造変化
  - ・半導体メーカーの新たな再編
  - ・半導体商社の優勝劣敗が鮮明に

### 当社の状況

- ◇売上高の低迷
- ◇収益体質の課題
  - ・利益率(売上総利益、営業利益)の低迷

## 【基本的な姿勢】

**「持続的成長」と「健全経営」を目指す**

## 【具体的な取り組み】

### 第2、第3の柱となる事業の育成

◇海外半導体デバイス事業等の更なる強化

[参考]第8次中期経営計画の修正

### 企業体質の更なる改善

◇収益体質と財務体質の改善

## 第2、第3の柱となる事業の育成

### ◇海外半導体デバイス事業等の更なる強化

#### ・新規リソース開発プロジェクトの推進

目的：当社の持続的成長を果たすための新規リソースの発掘

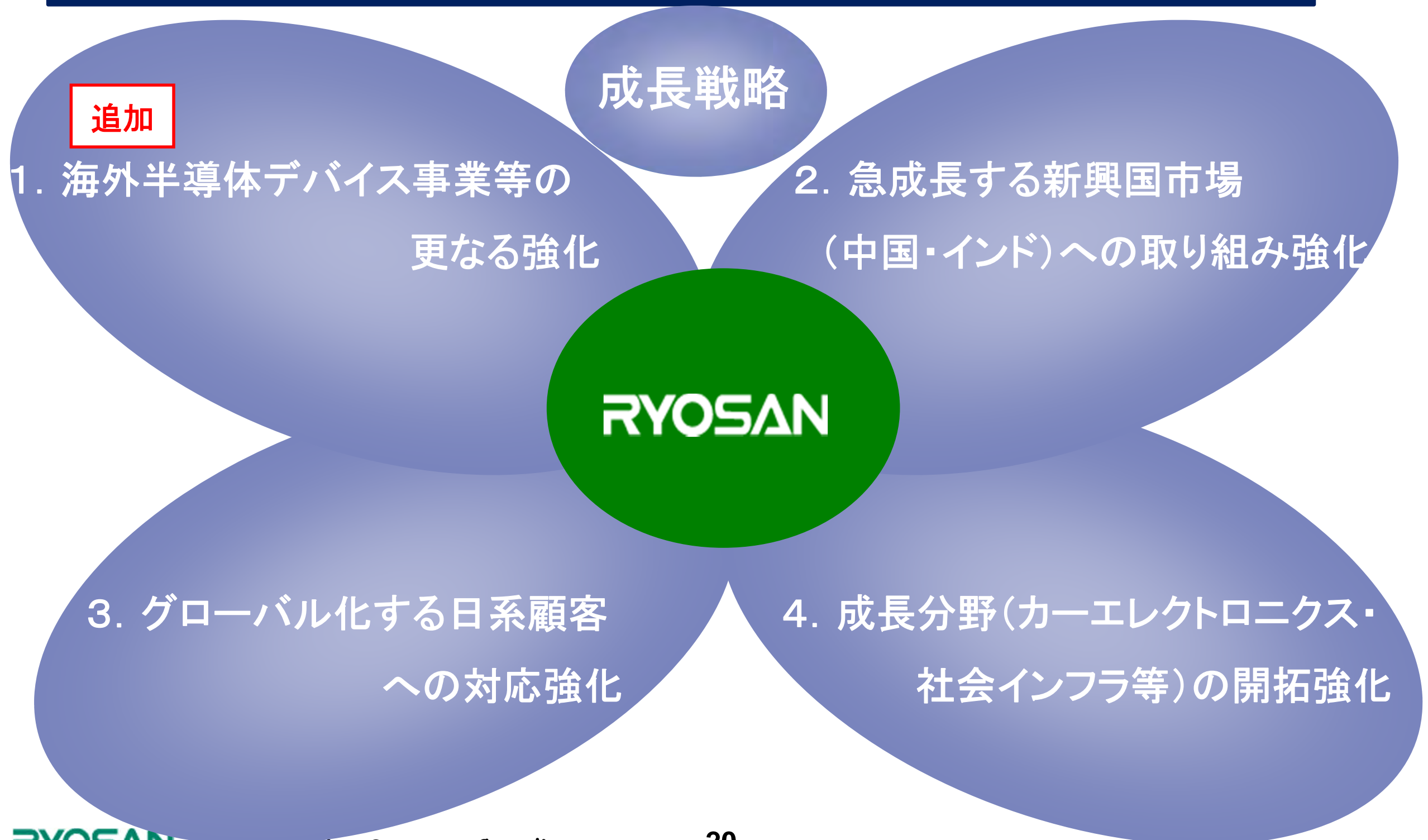
- 目標：・当社グループ全体に展開できる新規リソースで早期に業績貢献する  
・新規リソースによって当社の事業拡大が可能かどうか判断する

#### ・海外半導体デバイス事業の更なる強化

目的：海外半導体デバイスビジネスを成長戦略として、再チャレンジする

- 目標：海外半導体をメインで取り扱う各子会社（サクシス、ジャイロニクス）で  
数百億円規模の売上高を目指す

## 第8次中期経営計画の修正



## 企業体質の更なる改善

### ◇収益体質の改善

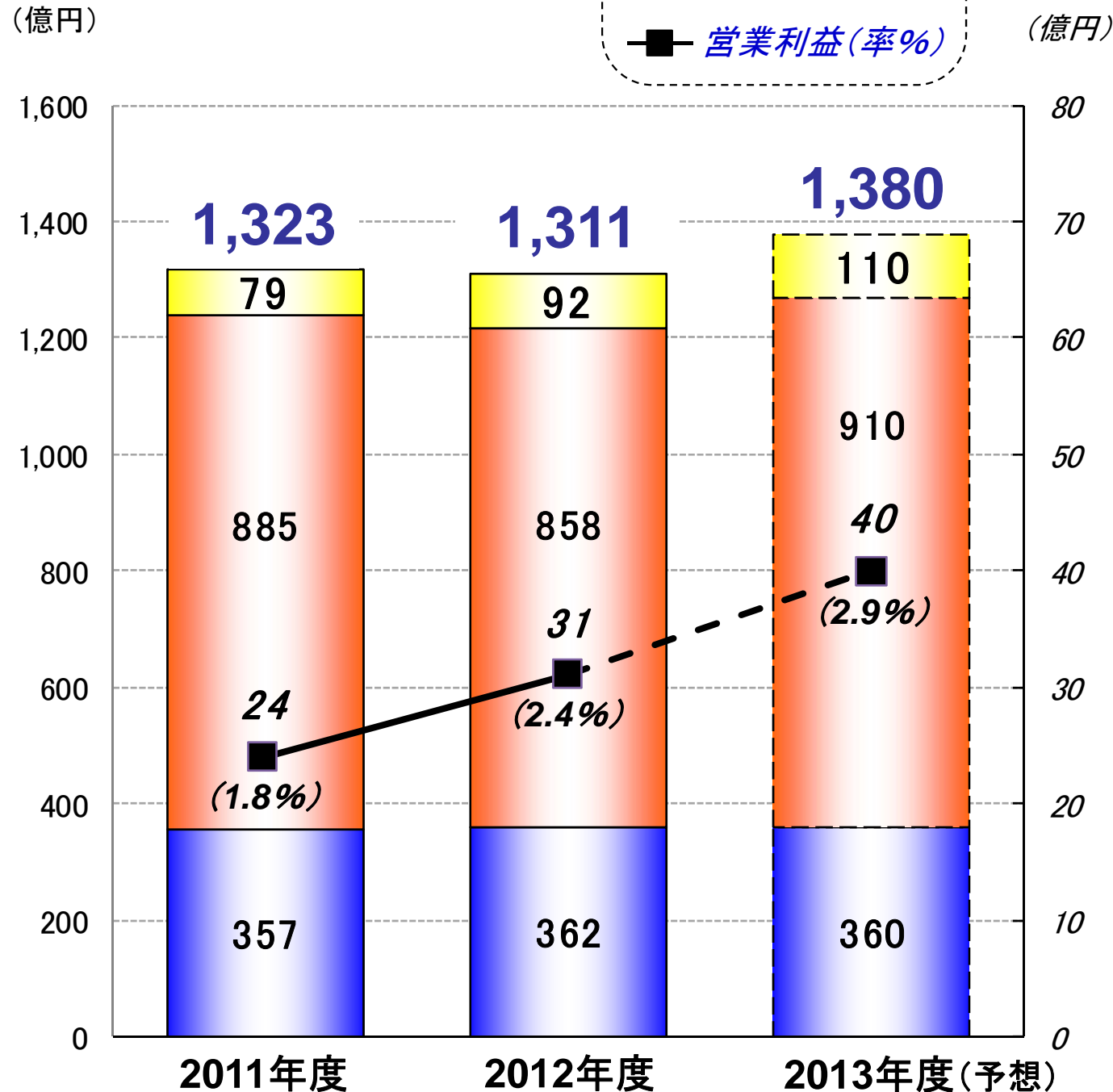
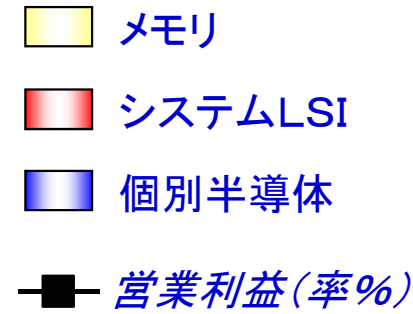
- ・利益率改善に向けて間断なきチャレンジ
  - ↳ 技術サポートなど付加価値を付けた  
営業活動の実践により適正な売上総利益率を  
確保する

### ◇財務体質の改善

- ・棚卸資産回転月数の適正化：目標1ヶ月未満
  - ↳ キメの細かい納期管理を徹底する事で  
無駄な在庫を削減する

# 半導体事業の取り組み

## 売上高推移(商品別)



## 13年度の取り組み

### ◇重点攻略市場

- ・車載・電装
- ・社会インフラ
- ・通信機器

### ◇具体的な取り組み

#### 国内サプライヤー

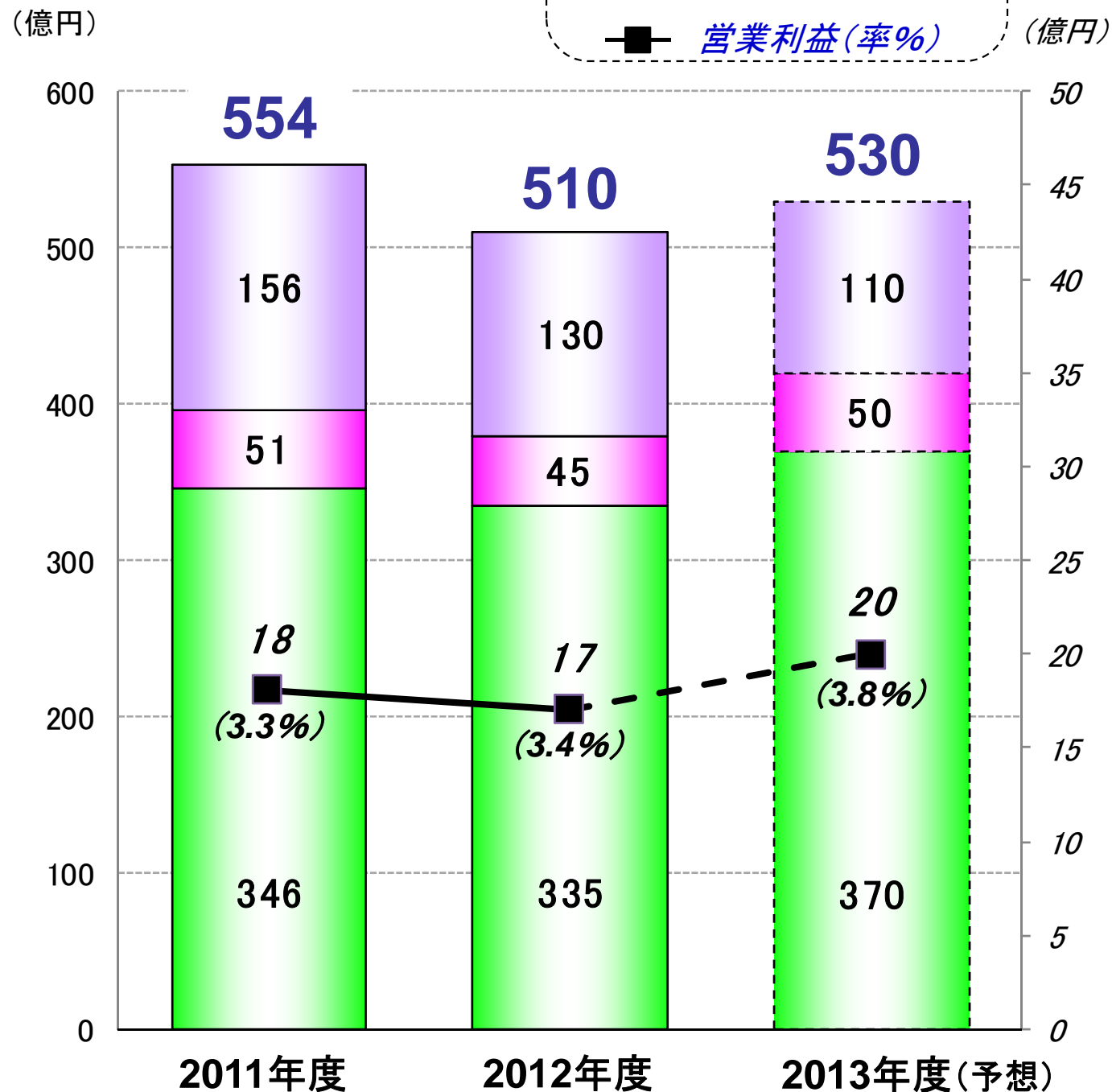
- ・新市場の開拓と攻略  
(スマートグリッド、LED照明等)
- ・新規移管顧客の深耕
- ・現地デザインハウスとの協業による  
海外ローカル顧客への拡販  
(中国、韓国)

#### 海外サプライヤー

- ・既存サプライヤーの販売体制の強化

# 電子部品事業の取り組み

## 売上高推移(商品別)



## 13年度の取り組み

### ◇重点攻略市場

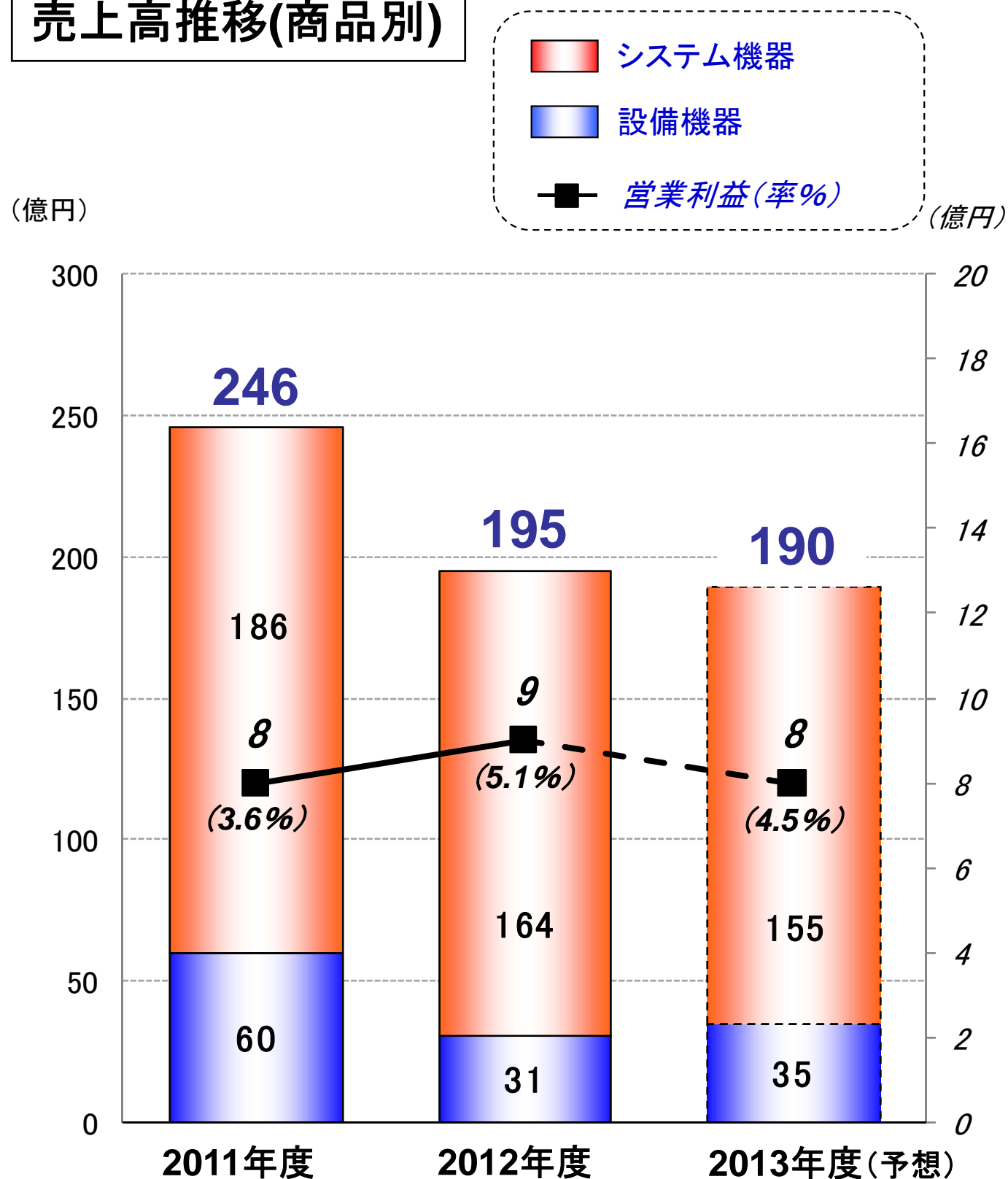
- ・車載・電装
- ・社会インフラ
- ・通信機器

### ◇具体的な取り組み

- ・品揃えの強化  
(LED、光学式トラックハット、太陽電池、センサ等)
- ・海外市場での拡販強化  
(中国電子部品専売部の新設)
- ・成長分野の開拓  
(車載・電装、社会インフラ、情報通信)

# 電子機器事業の取り組み

## 売上高推移(商品別)



## 13年度の取り組み

### ◇重点攻略市場

- ・車載関連
- ・社会インフラ
- ・環境エネルギー

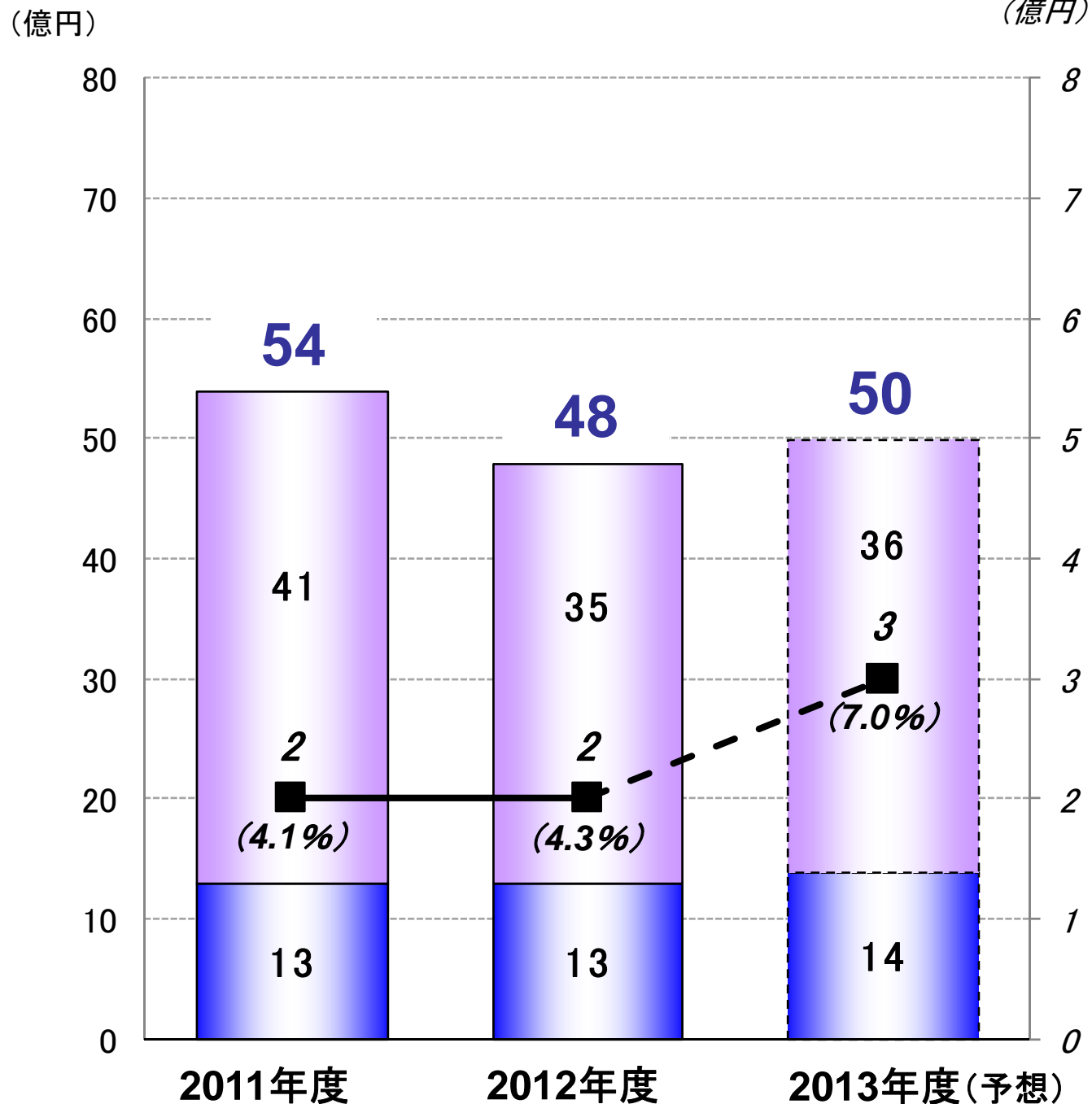
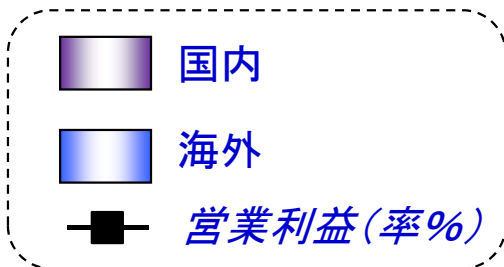
### ◇具体的な取り組み

- ・品揃えの拡充  
(台湾・中国サプライヤー、  
中堅設備機器ベンチャー等)
- ・新規ビジネスモデルの取り込み  
(EOL、受託加工サービス、素材 [磁気シート等]  
ODDユニット、車載向けリチウムイオン電池)
- ・成長分野の市場・顧客開拓  
(社会インフラ、環境エネルギー、次世代半導体)
- ・グローバル対応  
(中国、台湾市場開拓)



# 生産事業の取り組み

## 売上高推移(地域別)



## 13年度の取り組み

### ◇重点攻略市場

#### 国内

- ・エネルギー
- ・産業・FA
- ・車載・電装
- ・重電
- ・エレベータ
- ・医療機器

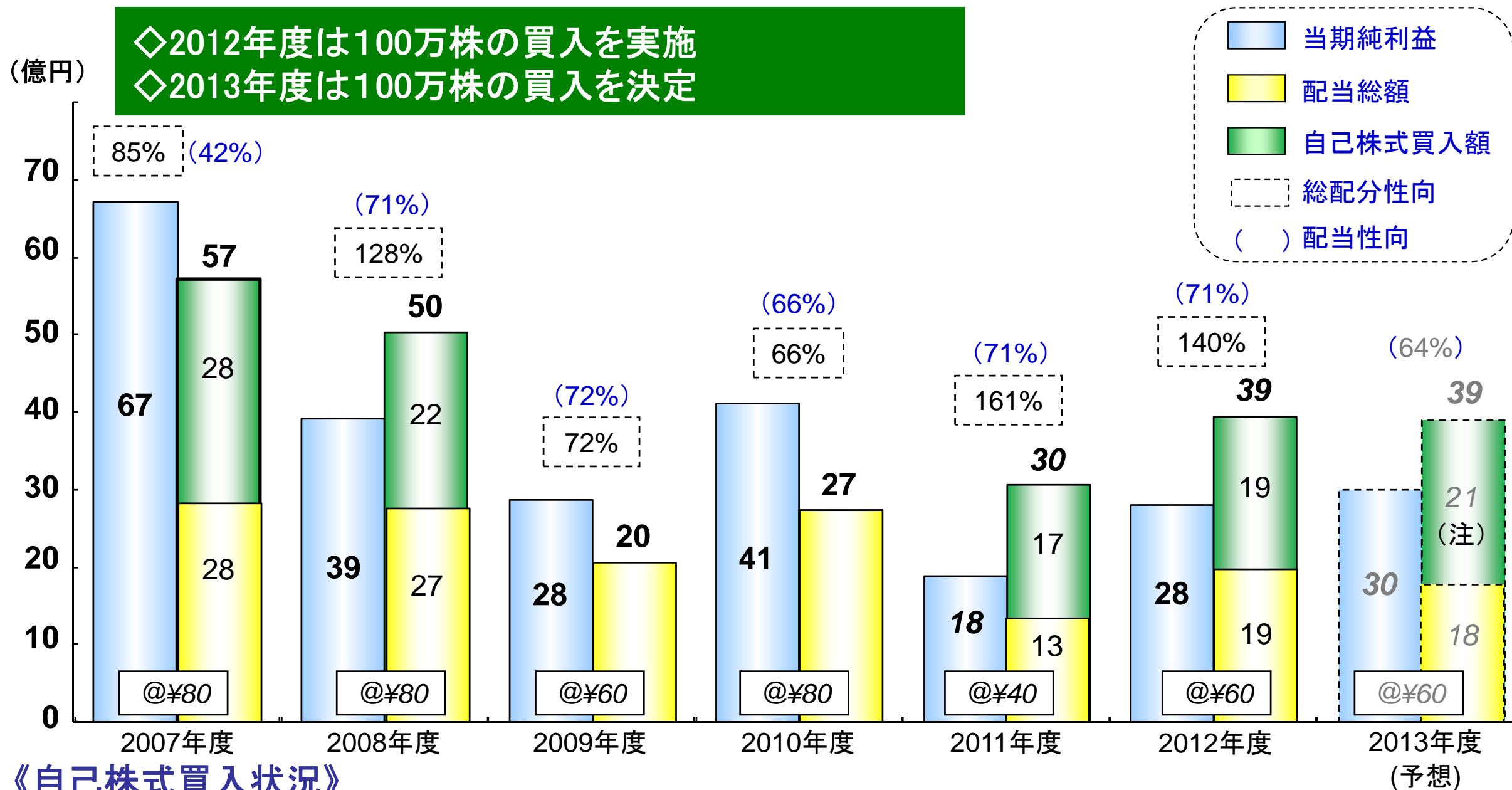
#### 海外

- ・エアコン
- ・OA
- ・車載・電装

### ◇具体的な取り組み

- ・魅力ある市場へのリソース集中  
 国内:車載・電装、重電、FA、エネルギー、  
 インフラ、医療機器など  
 海外:エアコン、車載・電装など  
 より高付加価値へ
- ・新製品、新技術の投入による事業拡大  
 (液冷、WC機能向上、新素材など)
- ・工場の収益力向上、全体最適生産  
 体制強化とグローバル化の推進

# 当期純利益と配当総額・自己株式買入額の推移

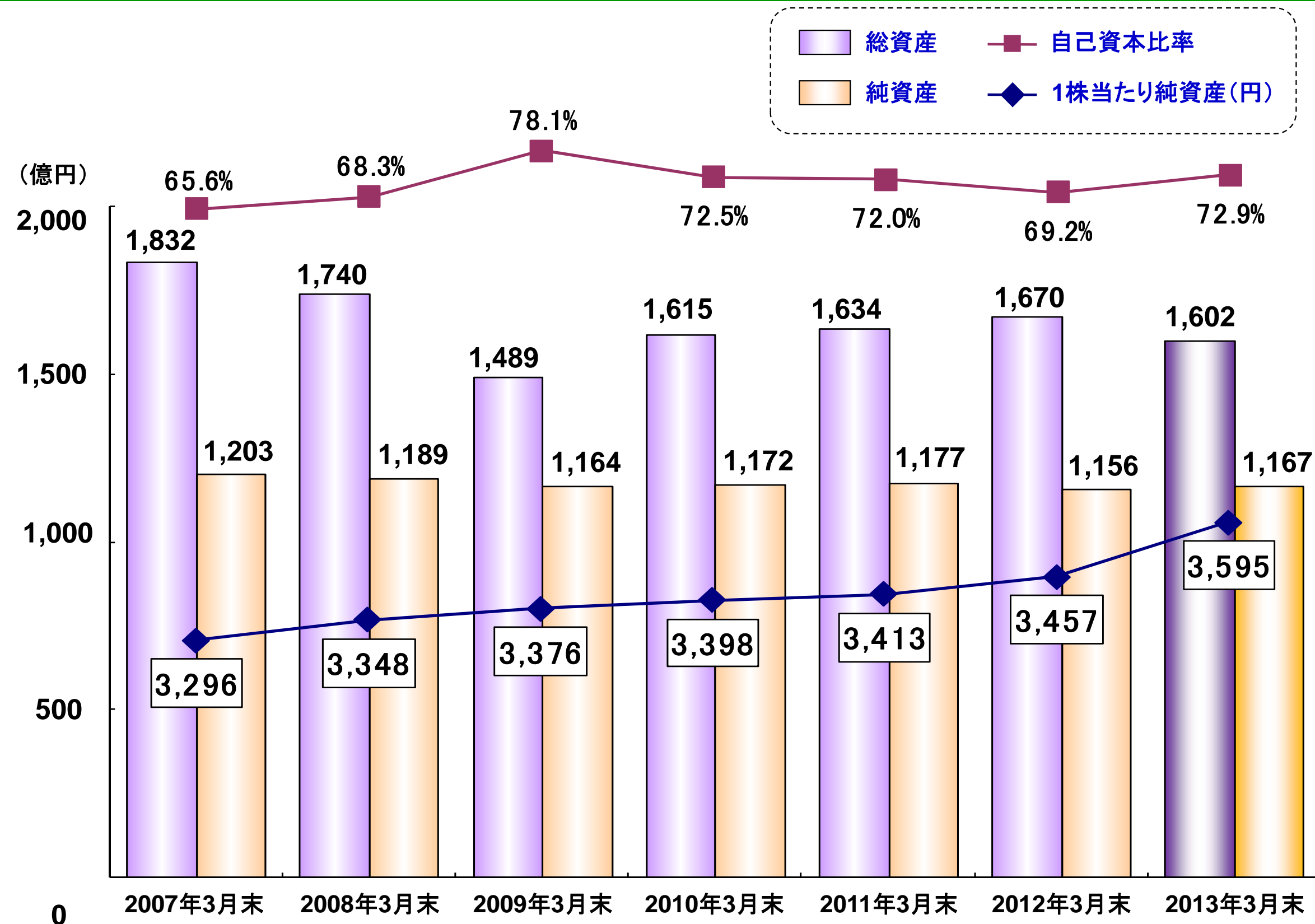


(注)2013年5月24日及び5月27日発表の自己株式取得に関するお知らせより

キャッシュフロー	2011年度	2012年度	主な増減要因
	(単位:百万円)		
営業CF	△8,356	17,689	<ul style="list-style-type: none"> <li>税金等調整前当期純利益 41億46百万円</li> <li>売上債権の減少 △149億41百万円</li> <li>たな卸資産の減少 △63億19百万円</li> </ul>
投資CF	△936	2,485	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期預金の払い戻しによる増加 30億円</li> </ul>
財務CF	419	△4,874	<ul style="list-style-type: none"> <li>外貨建て短期借入金の減少 △10億86百万円</li> <li>配当金の支払い △16億73百万円</li> <li>自己株式の取得による支出 △19億83百万円</li> </ul>
フリーCF	△9,292	20,174	
現金及び現金同等物残高	34,113	50,463	

# 連結財政状態の推移

<補足資料-2>



# 【別添】 技術活動の紹介

An Electronics Systems Coordinator

2013年5月29日

株式会社 リョーサン

取締役

技術本部長 坂田 敏文

## 【技術の方向性】

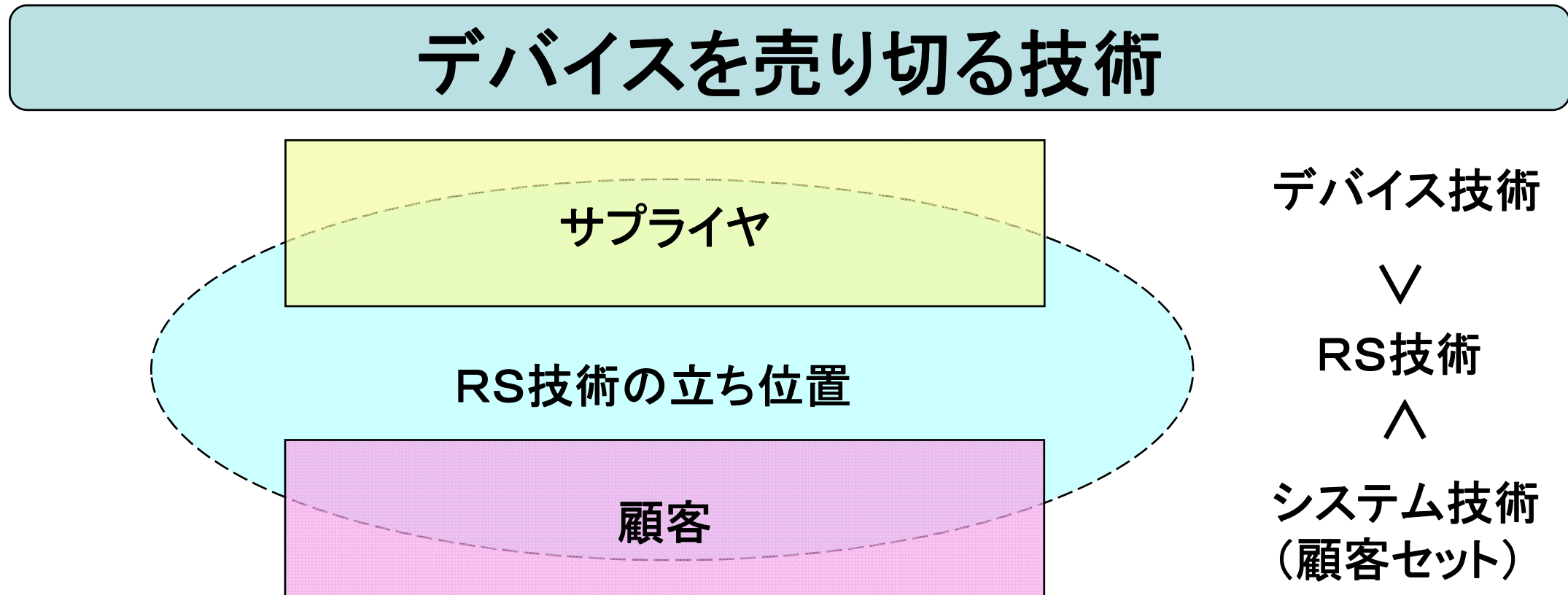
- ・得意分野の拡大とシステム技術力の深耕
- ・成長市場に向けた技術の拡充とグローバル展開

## 【中期技術戦略】

### ～売り切る技術の強化～

- システム技術力(要素技術含む)と提案力の強化
- 受託開発(ASIC・ソフト開発)を通じた開発力の強化
- サプライヤを補完する技術サポート力  
(デバイス応用技術力)の強化
- 成長市場への保有技術のグローバル展開  
韓国、中華圏、インド市場でのデザイン・イン推進

## 【技術の立ち位置】



### 個々のお客様の実情に合わせた実戦技術の提供と追求

#### ■ 実戦の積重ねで培ったデバイス応用技術力 & 開発技術力

I. デバイスの応用上の特性・問題点を知り尽くし、  
デバイスの性能を最大限に引き出す技術力

II. 顧客固有の開発スタイル、セット仕様(システム)を  
熟知した具現化力、提案力

## ■システム技術力(要素技術含む)と提案力の強化

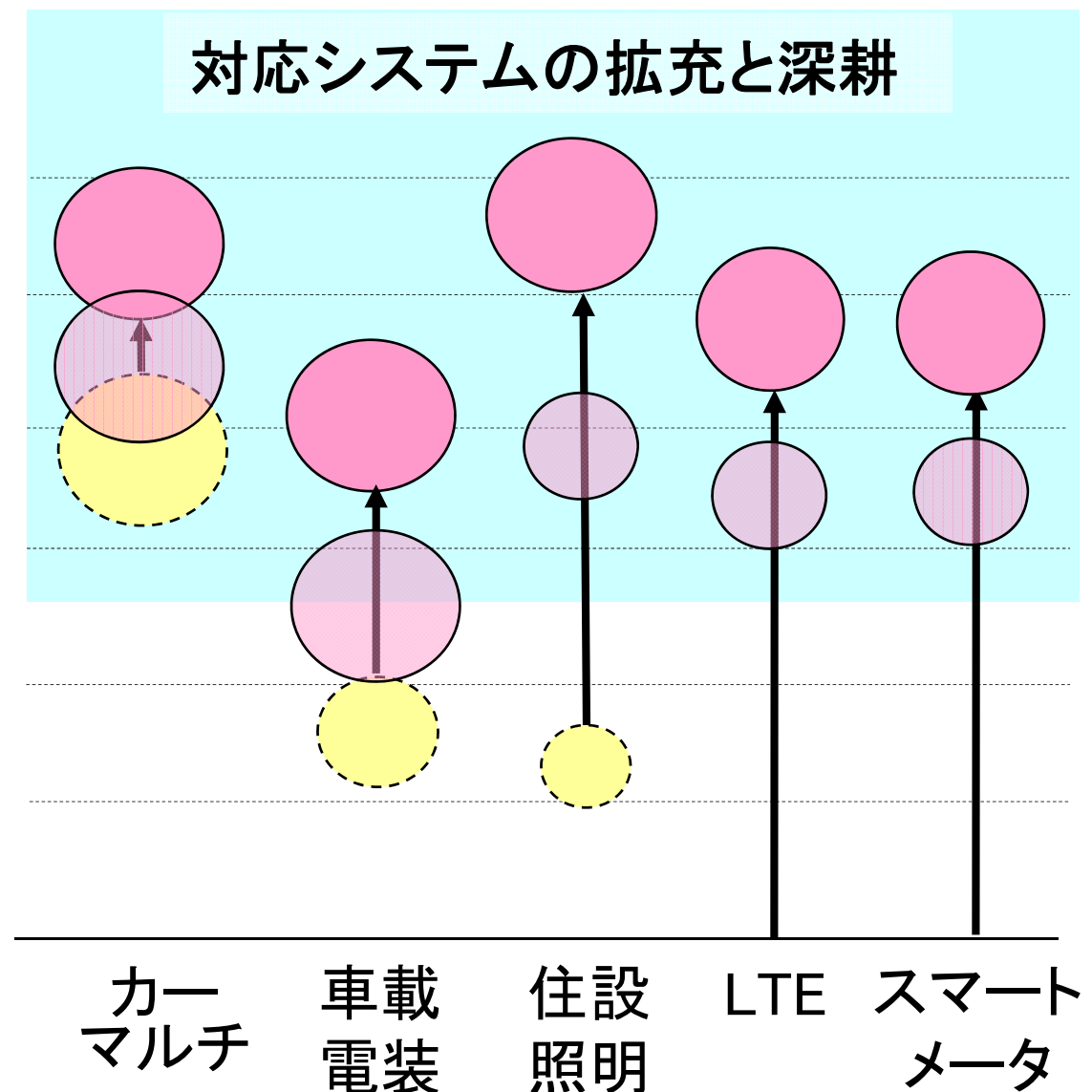
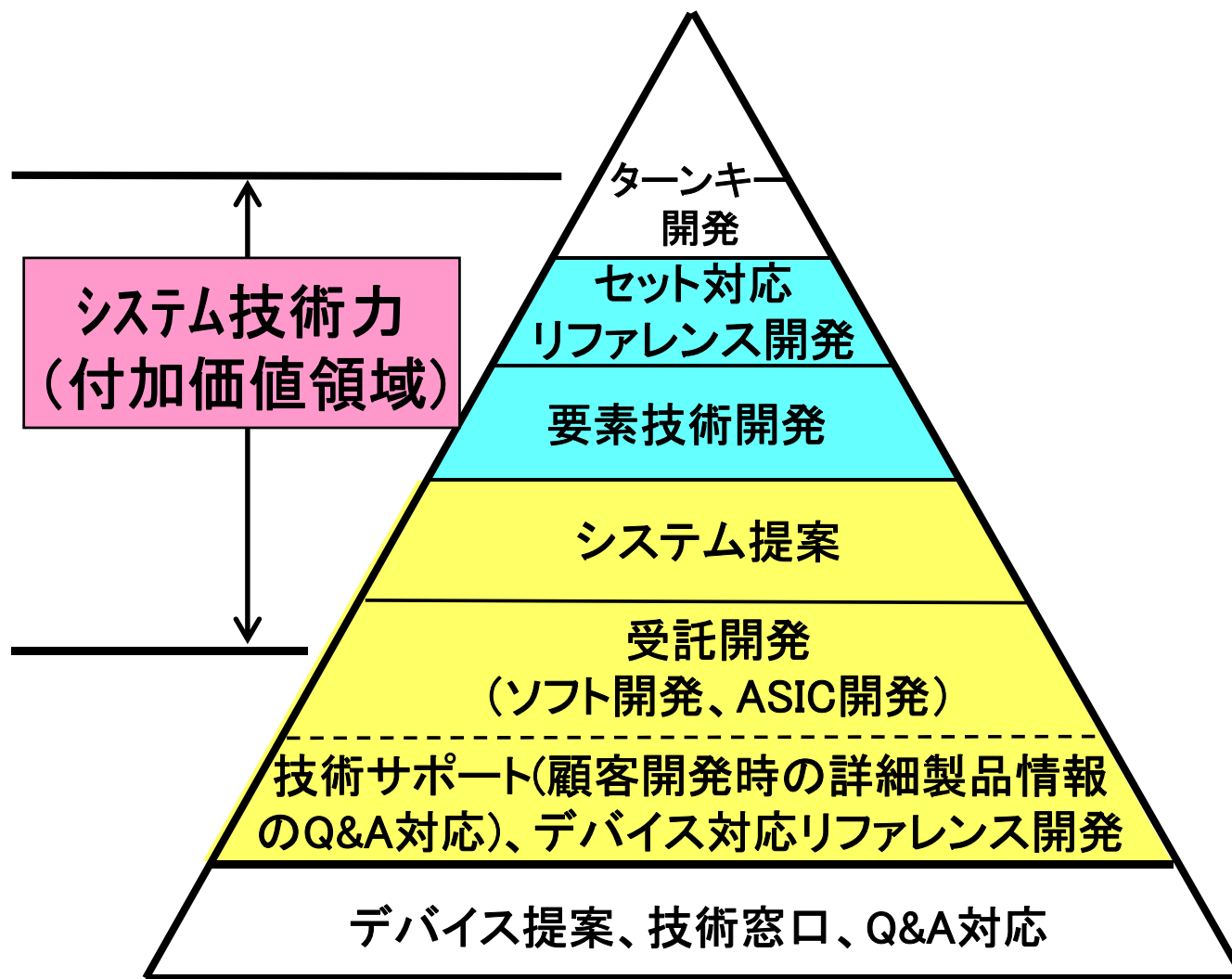
### 中期技術蓄積項目

システム	システム技術・要素技術	主な対象顧客
車載・電装	車内LAN(EthernetAVB制御技術)、機能安全 各種ECU(ボディ系、EPS、ACC)、車載カメラ ディスプレイオーディオ(MirrorLink、Miracast、Linux) イモビライザ(キーレスエントリー)	車載メーカ各社
住設機器	スマートグリッド・家庭内電力管理システム 省電力LAN制御技術(オフィス用) LED/有機EL照明技術 電源システム(AC-DC、DC-DC)	国内外スマートメータ各社、LED照明、 太陽光発電各社 など
通信機器	無線通信技術(LTE、Wi-Fi、Bluetooth-LowEnergy) ルータ	携帯端末、車載ナビ、 OA機器メーカ各社
モバイル機器	DSC/監視カメラ(画像処理、ノイズリダクション、 画像通信I/F)	DSCメーカ、業務カメラメーカ各社
共通要素 技術	PFC電源ICの制御技術(アナログ) ARMマルチコア対応技術(Cortexシリーズ)	電源顧客、 OA機器顧客



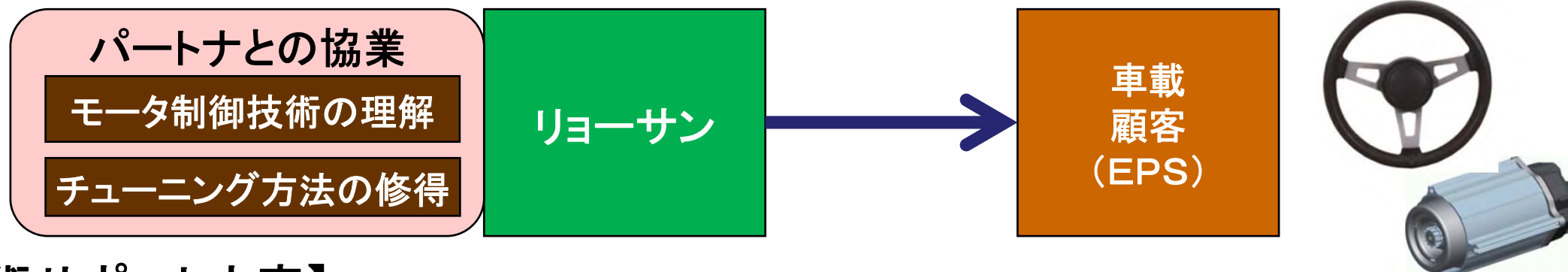
# 対応システムの拡充と深耕による付加価値領域の強化

- 11年度対応領域
- 12年度状況
- 中期計画13年度目標



# 【対応システムの拡充①車載モータ制御】

モータ制御の技術ノウハウを持つパートナーとの協業し、モータ制御技術の修得および顧客仕様に合わせたEPS用モディファイプログラムを開発。



## 【技術サポート内容】

- ①顧客モータユニットに合わせたモディファイと動作検証
- ②MCALサンプルプログラム、ブートプログラムの設計

※MCAL :AUTOSAR準拠のドライバプログラム



：リョーサン設計

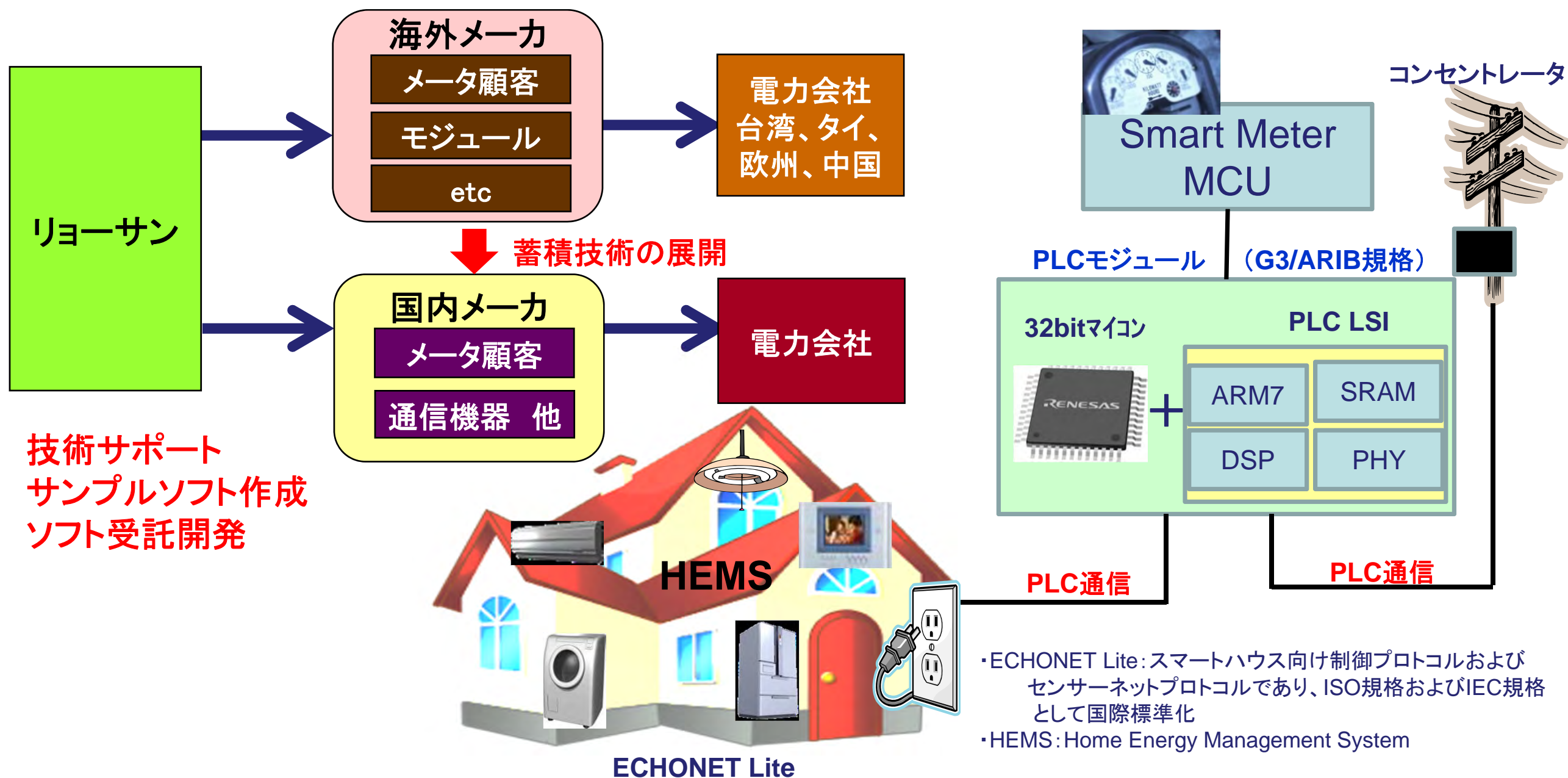
：リョーサン+DH設計

# 【対応システムの拡充②電力線通信(PLC)】

An Electronics Systems Coordinator

REL製PLC用LSIをベースに、海外ビジネスにて技術先行蓄積  
国内市場へ技術展開を行い、スマートグリッド市場に対する売上拡大を目指す

PLC: Power Line Communication(電力線通信)



# 【対応システムの拡充③通信規格Miracast】

An Electronics Systems Coordinator

スマートフォンと車載機等を「Wi-Fi (無線)」で繋ぐ新規格

- ・スマートフォンの画面(機能)を車載機に表示
- ・車載機側の操作で、スマートフォンが動作

【使用例】  
スマホを利用して  
ネットワーク接続



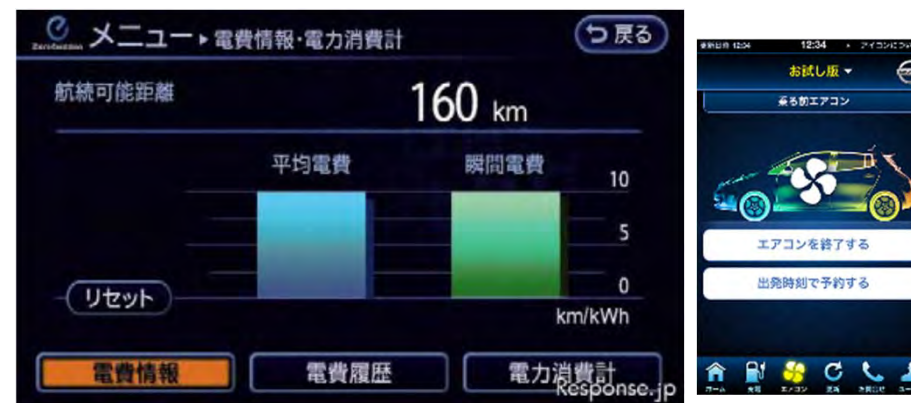
【使用例】

スマホのナビアプリを車載機で使用



【使用例】

車載機の情報スマホに表示



デバイス:ルネサス製  
R-CAR、R-Mobile

ミドルウェア:パートナー製  
Miracastスタック

リョーサン



+

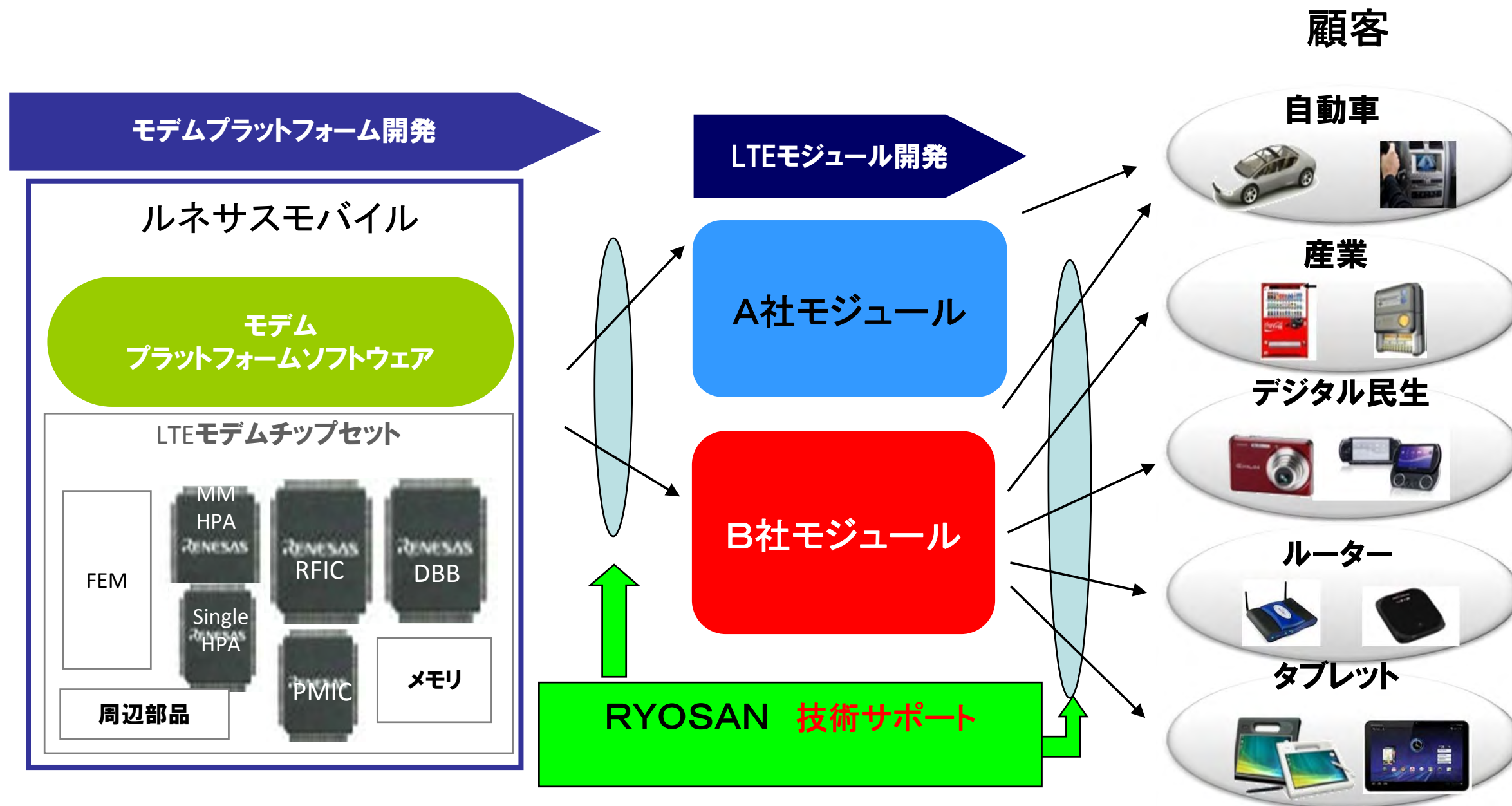


車載機メーカー

技術サポート

# 【対応システムの拡充④LTE】

次世代携帯電話(3.9G以降)の「LTE (Long Term Evolution)」技術を先行蓄積  
モジュールメーカーと協業し、幅広い分野に対しDIを推進中



## ■受託開発(ASIC・ソフト開発)を通じた開発力の強化

### 【主な開発実績】

		顧客	セット	プロセス	備考
A S I C 開 発  24件		A社	遊技機	MF2	継続商談の獲得
		B社	DSC	CB40LR	画像処理回路の技術修得 (仕様書からの設計力強化)
		C社	工作機 モーションコントローラ	CB40LR CB40LR	通信IP(Giga-Ether)の技術修得
		D社	LBP	CB40LR	ARMのバスI/F技術の応用 (仕様書からの設計力強化)
		E社	MFP	UMC(130nm)	ファラデー製ASICのDI拡大
		顧客	セット	デバイス	備考
マ イ コ ン 開 発  126件		F社	ディスプレイAudio	R-Mobile	MirrorLINK 新規技術修得
		G社	車載オーディオ	V850E2/SK4	DH連携強化による受託開発の拡大
		H社	タブレット	RL78/G13	新規成長分野での顧客獲得
		I社	アンサーバック	RL78/F12	新規車載電装分野の拡大
		J社	ドアロック	RL78/F12	新規車載電装分野の拡大

## ■サプライヤを補完する技術サポート力 (デバイス応用技術力)強化

- ・海外サプライヤ依存から自己完結を目指したデバイス応用技術力の向上  
高度な応用上のデバイスQ&A対応力、クレーム解析力等

技術力強化の為のアクションアイテム	対象システム、製品	サプライヤ
キット(システム)提案	白物家電、照明、カーマルチ	NXP、Micrel
リファレンスボード/ソフト設計	電源 LED照明 音声認識 近距離無線	NXP、Micrel NXP、ST NXP NXP
デバイス応用評価	Gigabit Ethernet PHY Ripple Blocker MEMS	Micrel Micrel ST
不具合解析と問題点切分け、解決策提案	取り扱い全製品	NXP、Micrel、ST

# 【技術サポート事例① タッチパネル】

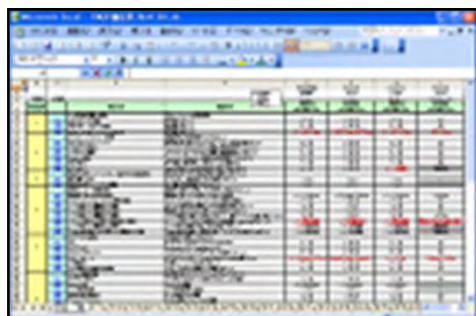
An Electronics Systems Coordinator

仕様検討、ソフトウェア設計、パネル/センサ設計、FPC設計、故障解析の  
トータル技術サポートを実施。モジュールメーカーの技術サポートも実施

## ①「仕様決め/SW設計サポート」

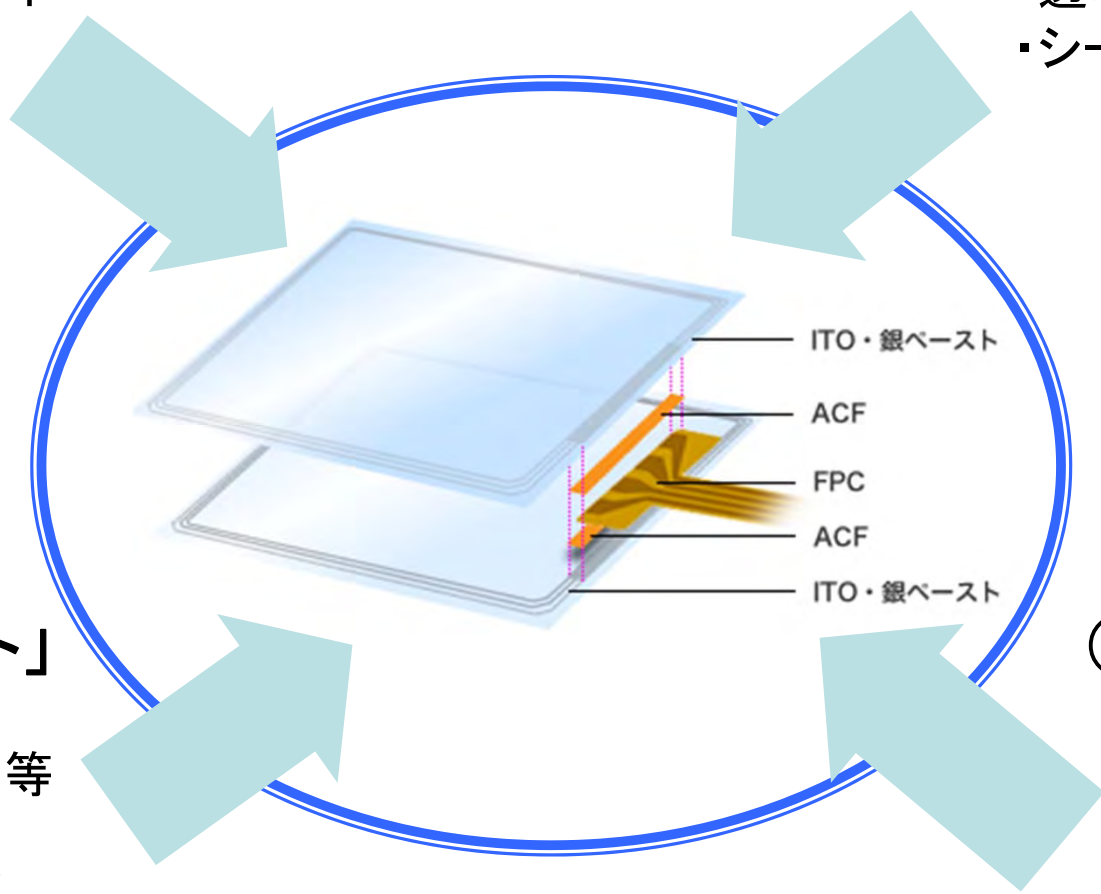
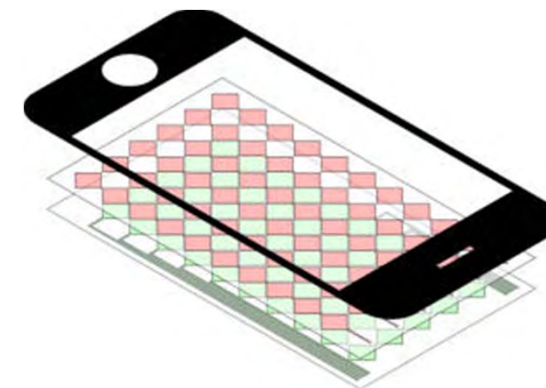
- ・チューニング作業サポート
- ・SWの動作検証 等

〈動作検証レポート例〉



## ②「パネル/センサ設計サポート」

- ・透明電極の形状検討、提案
- ・シールド付加などのノイズ対策 等



## ③「FPC設計サポート」

- ・シールド設計
- ・LCDドライバノイズ対策 等

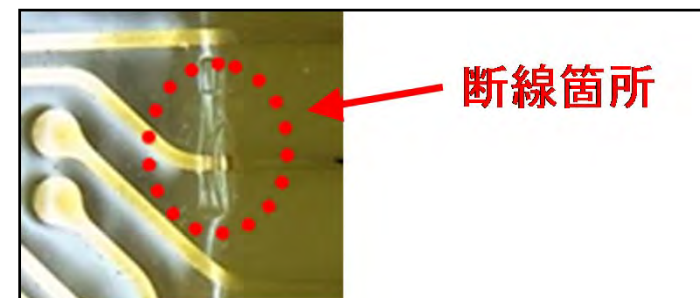
〈レイアウトの修正提案図例〉



## ④「故障解析サポート」

- ・原因の切分け(IC起因/パネル起因)
- ・故障箇所の判別、検査 等

〈断線箇所の報告例〉

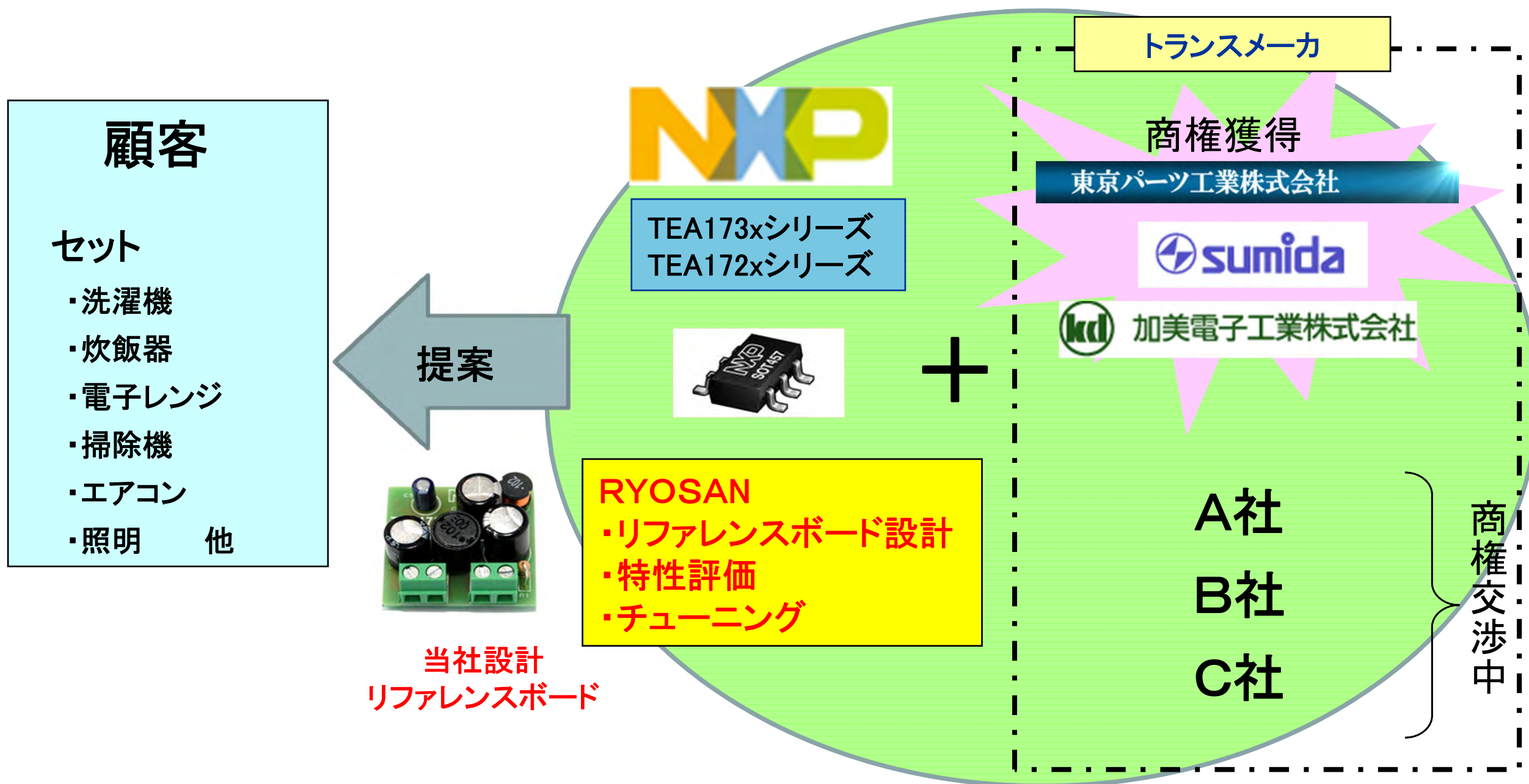




# 【技術サポート事例② キットビジネス】

An Electronics Systems Coordinator

NXP製電源IC + 電源システムを構成するトランスとのキットビジネス  
トランスメーカーとの協業推進によりトランスの商権も獲得

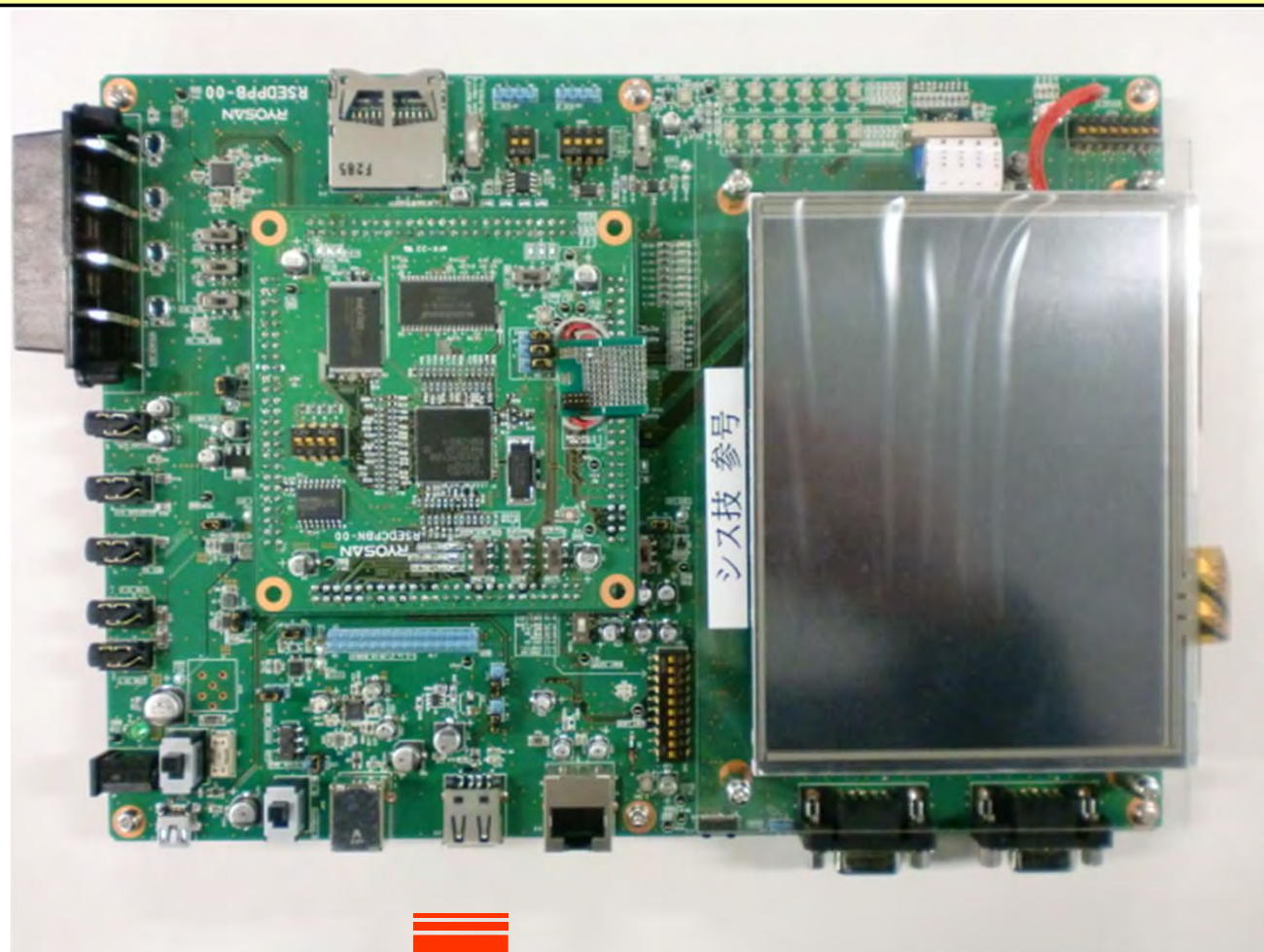


# 【技術サポート事例③ リファレンスボード】

An Electronics Systems Coordinator

顧客システムを実現するリファレンスボードを独自開発

拡販対象の当社取扱製品(半導体、電子部品)を搭載したソリューションを構築



開発中

ターゲット アプリケーション

- (1) タッチパネル表示モニタ (例: 太陽光パネル、DPF、etc)
- (2) 音声認識ソリューション (例: 電子レンジ、エアコン、etc)

## ボード仕様概要

CPU	Cortex-M4/M0 (dual) 204MHz
メモリ	FLASH 1MB (CPU内蔵) 8MB (パラ) + 16MB (シリアル) SDRAM 16MB
通信I/F	USB HS Host/Device 10/100Mb Ethernet、RS232C IrDA、SD Card オーディオI/F (Mic/Line)
LCD	タッチパネル付 5.7インチTFT

基本となる表示・タッチパネルをベースとし、さまざまなI/F機能を有し、周辺回路接続する事によりスピーディーにデモ構築が可能

## ルネサス製品＋海外半導体＋モジュール

### ・重点システムへのキット提案推進

新規アイテムの検討、リファレンスボードによるキット提案推進

### ・新規商談情報、システム情報の共有化

対象システム例	キット提案事例
カーナビ/オーディオ	SOC・MCU・電源 (REL)＋Ether (Micrel)＋DRAM(Winbond)
DSC 一眼レフ/交換レンズ	MCU・ASIC(REL)＋MEMS (ST)＋電源・Ripple Blocker・CLS (Micrel)
プリンタ/POS	MCU (REL、NXP)＋メモリ (Winbond)＋電源・CLS・Ether (Micrel)
LCD表示モジュール	MCU (REL、NXP)＋FROM(Macronics) ＋DRAM (Winbond)＋電源・EEPROM (REL、ST)＋Ether (Micrel)

## 【提案用システムブロック図の開発と営業・FAEへの展開】

DSC、エアコン、冷蔵庫、IHクッキングヒータ、温水洗浄便座、血糖値計、電子ピアノ、ミシン、LEDシーリングライト、電源システム、メモリセレクションガイドなど

## 【成長市場へのグローバル展開】

### ■ 韓国・自動車顧客への技術サポート体制の強化

- ・2016年度 売上100億円を目指し、DI活動／技術サポートを展開中
- エンジン制御用マイコン、エアバック用マイコン、EPS用マイコン、ナビ用SoC、オーディオ用マイコン、各種パワーデバイス 等

### ■ 中華圏顧客へのDI/DW推進

- ・日本で蓄積した先行技術の展開、中国専売との連携による活動
- 携帯カメラ向け画像処理LSI、STB向けSoC、スマートメータ向けLSI、交換機向けASIC、車載用マイコン など

### ■ インド市場への進出

- ・I社向けSTB開発 1年間の出張技術サポート、2013年3月量産開始
- ・リョーサンインドとの連携による分野開拓活動